

## LTCC用前処理プロセス

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
LT-2000C	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ アルカリ性脱脂剤</li> <li>● 素材に対する影響が少ない</li> <li>● Ag、Cuペーストに効果が高い</li> </ul>	200ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LTCC基板</li> <li>● セラミック基板</li> <li>● Ag、Ag-Pd、Cuペースト</li> </ul>
AT-808	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 活性化促進補助剤</li> <li>● Pd活性化を均一に誘導する</li> <li>● 配線パターンを選択部分の活性化に卓効を呈します</li> </ul>	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LTCC基板</li> <li>● セラミック基板</li> <li>● Ag、Ag-Pd、Cuペースト</li> </ul>
AT-909	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pd活性化液(中性)</li> <li>● 微細、独立パターン上のめっきでリーク、かじり等をおこさない</li> </ul>	原液使用～500ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LTCC基板</li> <li>● セラミック基板</li> <li>● Ag、Ag-Pd、Cuペースト</li> </ul>
AFP-500	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pd残渣除去液</li> <li>● 印刷パターンレジストを痛めない</li> <li>● ダイシングライン中へ浸透したPdの除去</li> </ul>	500ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LTCC基板</li> <li>● セラミック基板</li> <li>● Ag、Ag-Pd、Cuペースト</li> </ul>
PD-SET2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ めっきリーク防止剤</li> <li>● 微細、独立パターン上のめっきでリーク、かじり等を防止する</li> </ul>	200ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ LTCC基板</li> <li>● セラミック基板</li> <li>● Ag、Ag-Pd、Cuペースト</li> </ul>